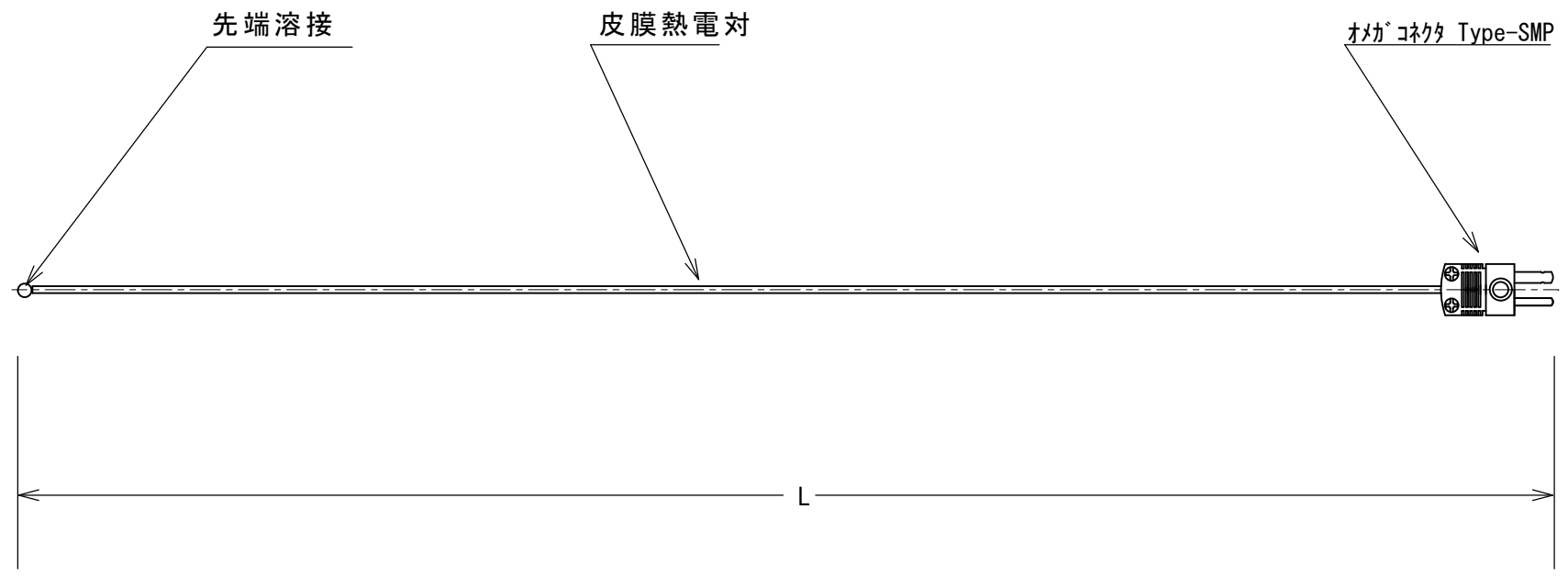


DRAWIN No. : OMC-0002

リード形状	K型皮膜熱電対
リード構成	0.32/1P
リード皮膜	テフロン (FEP)
末端処理	オメガコネクタ (Type-SMP)



L = (1M・2M・5M・10M)

UNIT : mm

7					設計温度 : -200 ~ 200 °C		
6					TOLERANCE JIS C 1602-1995	DATE 2011.11.01	CUSTOMER
5					CLASS クラス2 (0.75級)	SCALE - : -	TITLE
4					ELEMENT DIAMETER K Φ0.32	CHECKD BY	テフロン被膜 (FEP) K型熱電対
3					ELEMENT Q'TY シングルエレメント	DRAWN BY	TYPE
2					HOT JUNCTION 露出型		
1					大阪マイクロコンピュータ株式会社		
No.	PARTS	MATERIAL	Q'TY	REMARKS			